

新製品紹介

低反発・低反り難燃ソルダーレジストFPC

近年、スマートフォンやタブレット端末など電子機器の小型化・薄型化がますます進んでいます。それにしたがって、これらの機器に使用されるフレキシブルプリント配線板（FPC）は、筐体への組み込みやすさの要求が高まっております。当社はこの市場ニーズに応えるため、新しい感光性ソルダーレジストを用いた低反発・低反りFPCを開発しました。

このFPCは、従来のポリイミドベースのカバーレイフィルムを使用したFPCと比べて柔軟性

が優れています。曲げ加工がしやすく、曲げた状態で形状を維持するため、筐体への組み込みが容易になります。またフォトリソグラフィ方式で成型するためレジスト開口位置精度が高く、異方性導電フィルム（ACF）の接合にも優れています。更に環境汚染物質に該当する臭素系難燃剤を含まずに難燃性を有しており、UL 94 の認証も取得しています。

（プリント回路事業部 製造技術部 野口）

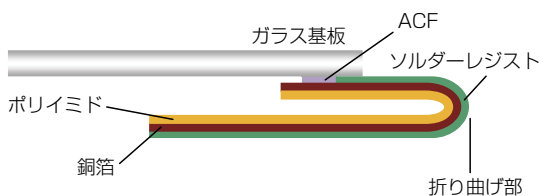


図1 製品使用イメージ

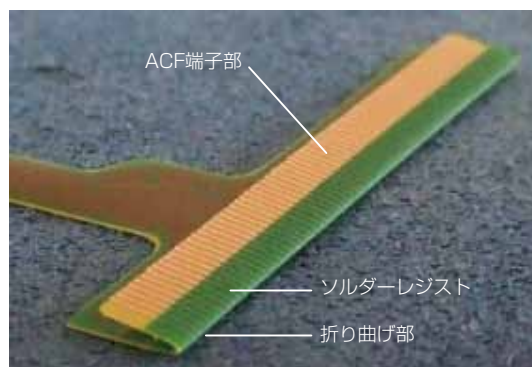
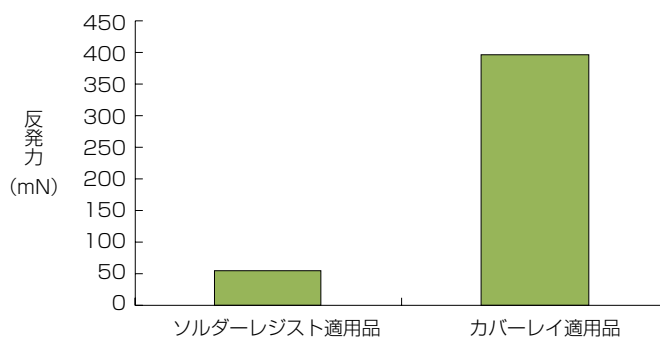


図2 製品使用例



ループスティフネス試験
 ソルダーレジスト 15 μm /CCLベース 25 μm
 カバーレイフィルム 38 μm /CCLベース 25 μm

図3 反発力比較

【お問い合わせ】
 エレクトロニクスカンパニー
 プリント回路事業部
 TEL : 043-484-3950 FAX : 043-484-3985
 E-mail : askfpc@jp.fujikura.com